

Singulation System

Model FMS3040-HC



Half-cut machine suitable for wettable QFN packages

ウェットابلQFNパッケージに適した ハーフカット装置

製品情報



日本語

- QFNパッケージのようなリードレスのデバイス製品の高精度なブレードカットを実現
- プロセスやフレームデザインに合わせてブレードカット(FMS3040-HC)またはレーザーカット(LGR1040)を選択可能
- 反り矯正の押さえ機構を用いたハーフカット深さ精度の向上



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
モデル		—	FMS3040-HC			
装置区分		—	ハーフカット 共用機		ハーフカット 専用機	
ワークサイズ	長さ	mm	150—300			
	幅	mm	40—100			
	厚み	mm	0.5—2.0			
パッケージサイズ	最小	mm	1×1			
	最大	mm	25×25			
基板反り量		—	3mm／300mm (Max.)			
ダイサー		—	Twin spindles, Twin tables			
外形寸法	モジュール	module	Cut Engine	Offload	Cut Engine	Offload
	幅	mm	1,960	1,500	1,960	740
	奥行き	mm	1,760	1,760	1,760	1,760
	高さ	mm	1,800	1,800	1,800	1,800
重量		ton	5.1		3.2	
ワーク供給部	タイプ	—	スリットマガジン			
	数量	pcs	4 (Max.) マガジン幅115mmの場合			
製品収納部	タイプ	—	Original Box		Slit magazine	
	数量	pcs	1		4 (Max.) マガジン幅115mmの場合	
キット交換時間		min	10		5	
製品搬送方式		—	Vacuum			
製品処理能力		SPH	6			

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。



本社

〒601-8105
京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.

台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.

韓国
TOWA Korea Co., Ltd.

シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

ドイツ
TOWA Europe GmbH

オランダ
TOWA Europe B.V.

アメリカ
TOWA USA Corporation

20250401-005-HQ